

949 / 950 / 951

Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig
Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

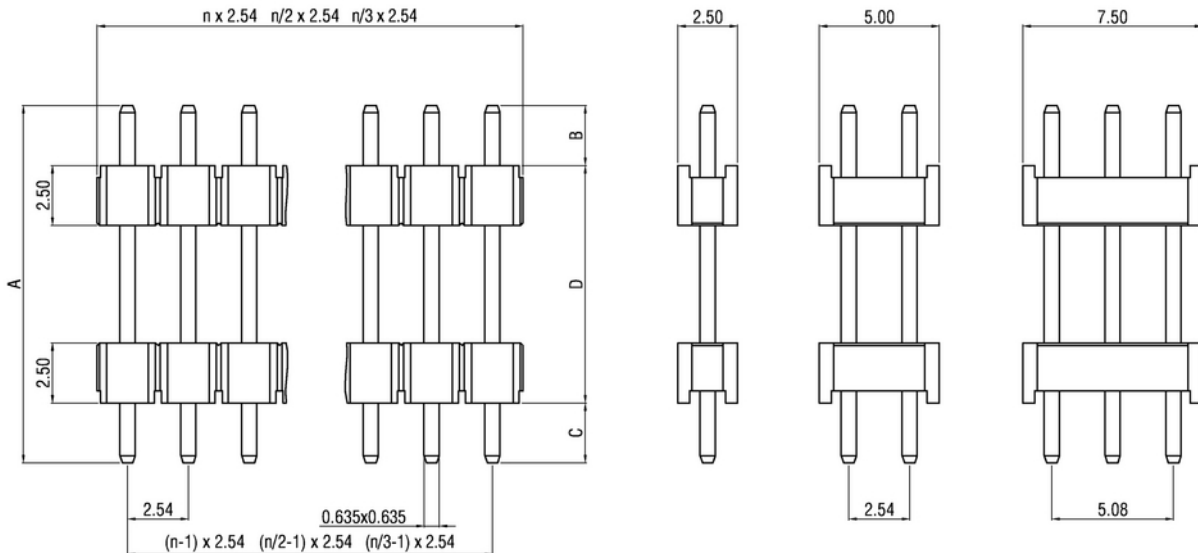
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.635mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{DC}
Test Voltage	1kV _{DC}
Nennspannung	250V _{AC}
Voltage Rating	250V _{AC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-40°C ... +125°C
Temperature Range	-40°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
 Mate with Female Headers:
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.
 Weitere siehe Kapitel B
 Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
 Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*
949	19	010	00
Gestanzte/geprägte Kontakte Stamped/formed contacts	16 A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm 17 A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm 18 A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm 19 A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm 20 A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm 21 A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm 22 A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm 23 A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm 24 A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm 25 A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm 26 A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm	001-050 Einreihig Single row 004-100 Zweireihig Double row 006-120 Dreireihig Triple row	00 Vergoldet Gold plated 10 0,25µm Gold 0.25µm gold plated 30 0,75µm Gold 0.75µm gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au 0,25µm / Sn 80 Sel. Au 0,75µm / Sn

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage.

B, C, D variable acc. to customers' specifications.
 We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches on request.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
 FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
 WEBSITE www.wpro.com

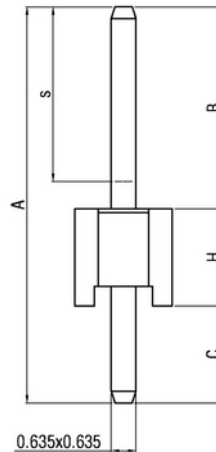
Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

Dimensions and PCB Layouts

Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

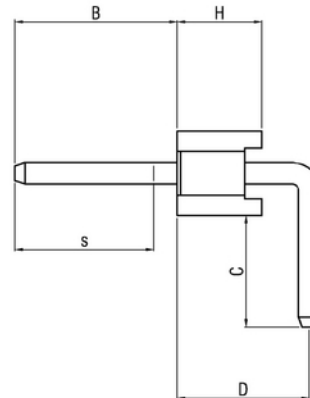
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



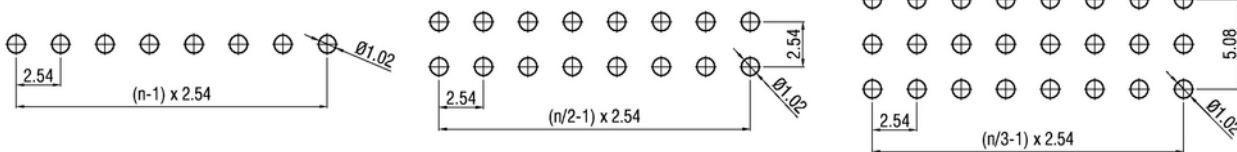
Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



PCB Layouts



Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

